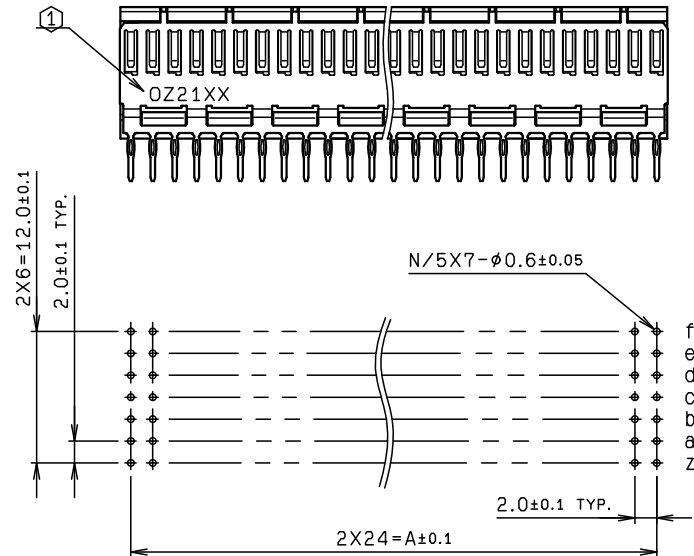
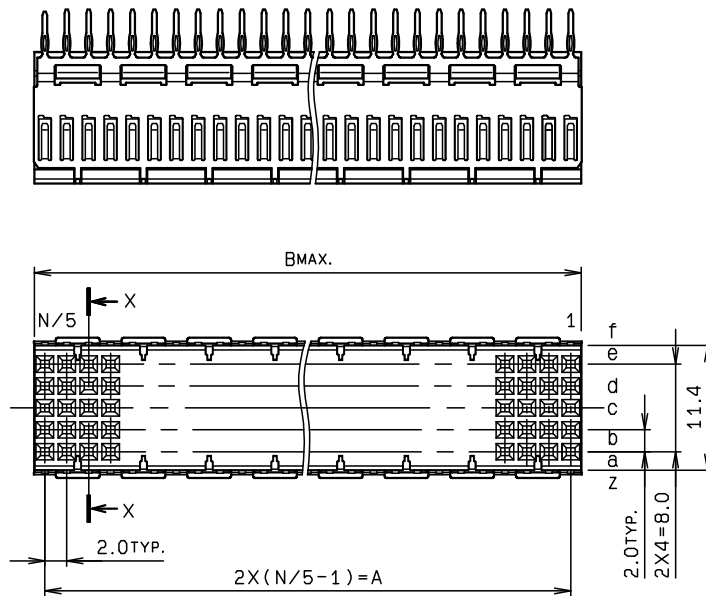
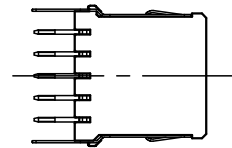
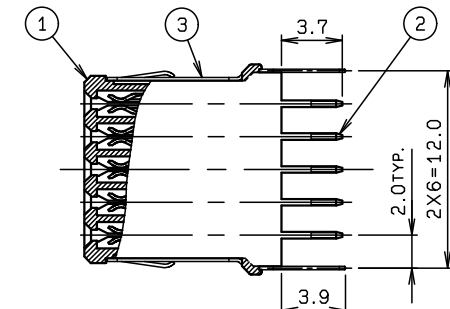
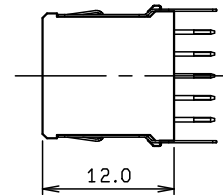




推奨基板取付け寸法 (部品面)

RECOMMENDED P. C. BOARD LAYOUT
(COMPONENT SIDE)ROHS規制対応
COMPLIANT WITH
ROHS REGULATIONS

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	INSULATOR		1	PBT (GF30%)		UL94V-0 COLOR:GRAY
2	CONTACT		N	PHOS-BRONZE		
3	SHIELD PLATE		2	PHOS-BRONZE		



SECT. X-X (S=3:1)

注 記
NOTE① 製造ロット番号表示
LOT. NO.製造年 YEAR 製造月 MONTH 製造日付 DATE
製造ラインコード LINE CODE

2. 適用基板仕様 APPLICABLE P. C. BOARD
基板厚 P. C. BOARD THICKNESS:
 $t=1.4\sim5.0\text{mm}$
穴径仕様 APPLICABLE T/H
下穴径 PREPARED HOLE DIA.:
 $\phi 0.7\pm 0.025\text{mm}$
銅めっき厚 COPPER PLATING THICKNESS:
 $25\sim50\mu\text{m}$
仕上り径 FINAL PLATED HOLE DIA.:
 $\phi 0.6\pm 0.05\text{mm}$

極 数 NO. OF POS.	A	B
95	36.0	38.0
110	42.0	44.0
125	48.0	50.0

型 番 27 8072 XXX 010 XXX +
P/N
接 頭 PREFIX
27:プラグ/プレスフィット
PLUG PRESS FIT TYPE
極数 NO. OF POS.
095:95POS.
110:110POS.
125:125POS.

バリエーション VARIATION
010:ポライジングキー無し、シールド付き
WITHOUT POLARIZING KEY
WITH SHIELD PLATE

めっき仕様 PLATING CODE

めっきコード PLATING CODE NO.	下地めっき UNDER COAT	接点部めっき CONTACT AREA	プレスフィット部 PRESS FIT AREA
518	Ni:1.2μmMIN.	Au:0.1μmMIN.	Au FLASH
519		Au:0.38μmMIN.	
515		Pd/Ni:0.65μmMIN. Au:0.1μmMIN.	
517		Au:0.76μmMIN.	
835		Pd/Ni:0.4μmMIN. Au 0.03μmMIN	Sn-Cu:1.2μmMIN. or 無光沢Sn:1.2μmMIN.

めっき PLATING
+ :Sn-Cu, Pb-free (8XXの場合)
Au FLASH,Pb free (5XXの場合)

TOLERANCE / 一般公差 (S)		PRODUCT SPEC / 製品規格		C	DCN21336	2021/04/21	R. ARAI		F. I KEGAMI
X < 10 ±0.2		UNIT		B	DCN19886	2019/08/30	R. ARAI	H. TAMAI	M. YOSHIDA
10 ≤ X < 30 ±0.25		mm		O	EDN-930	2005/07/13	Y. AYUKAWA	Y. SHIROYAMA	N. HAYASHI
30 ≤ X ±0.3		3RD		NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED
ANGLE / 角度		SCALE		PART NAME / 品名					
±3°		2 : 1		SERIES 8072 REC ASSY ST PRESS FIT					
DRAWN		DATE		WITHOUT POLARIZING KEY					
LI		2005/07/13		PART NO. / 製番					
DESIGNED		CHECKED		27 8072 XXX 010 XXX +					
Y. AYUKAWA		Y. SHIROYAMA		DWG NO. / 図番					
N. HAYASHI		N. HAYASHI		BJS 8072024					
KYOCERA				SHEET/REV					
				1/1 C					